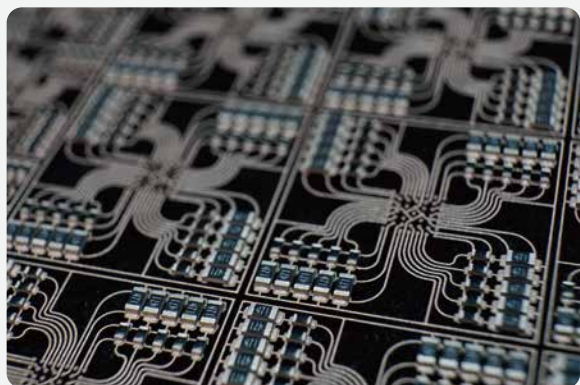


低温硬化型部品実装用ペースト

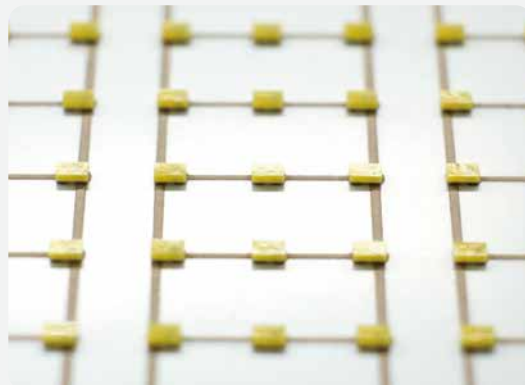
半田が使用できない低耐熱基材にも最適

用途

部品実装用途



イメージ：ガラスウェハへの実装



イメージ：ポリイミド基板へのLED 素子実装

特徴

- 低温実装が可能
- 優れた密着性
- 優れた応力緩和性



0201 チップも実装可能

ラインナップ & 特性

製品型番			AE8010
粘度	BH型	dPa・s	1,000 ~ 1,500
硬化条件	本硬化		120°C × 30分
体積抵抗率 [代表値]		Ω・cm	1.5E-04
熱伝導率		W/mK	10

